



RE900-03

- Fibra dura di vetro epossido FR4 1,50 mm
- Doppia faccia 35 µm Cu
- Contatti metallizzati (PTH)
- Superficie Ni/Au chimico, rivestito con maschera di saldatura
- Circuito di adattamento per TSOP I 20, 24 (0,50 mm)
- Diametro del foro 1,00 mm
- I dati Gerber per la produzione della pasta di saldatura vengono messi a disposizione gratuitamente su richiesta
- Dimensioni 16,73 x 30,94 mm

N. modulo	Tipo	Pitch	Pin	Dimensioni (mm)
RE900-03	TSOP I	0,500 mm	20, 24	6,00 x 16,00